

股票简称：高斯贝尔

股票代码：002848



高斯贝尔数码科技股份有限公司

非公开发行A股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二一年七月

## 目 录

一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况.....	2
二、募集资金投资项目的可行性分析.....	2
（一）年产 450 万平方米高频高速覆铜板山东基地建设项目.....	2
（二）补充流动资金.....	6
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	7
（一）本次发行对公司经营管理的影响.....	7
（二）本次发行对公司财务状况的影响.....	7
四、募集资金投资项目可行性分析结论.....	7

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

## 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》中相同的含义。

## 一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 36,706.14 万元（含本数），扣除发行费用后募集净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	年产 450 万平方米高频高速覆铜板山东基地建设项目	28,000.00	28,000.00
2	补充流动资金	8,706.14	8,706.14

若本次非公开发行 A 股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后依照相关法规规定予以置换。

## 二、募集资金投资项目的可行性分析

## （一）年产 450 万平方米高频高速覆铜板山东基地建设项目

## 1、项目概况

本项目由公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司实施，实施地点位于山东省潍坊市寒亭区嘉实科技城。项目计划通过租赁生产厂房，引进国内外先进生产设备，建设新生产线，扩大高频高速覆铜板的生产规模。项目达产后，形成新增高频高速覆铜板产能 450 万平方米，新增粘结片产能 250 万平方米。

## 2、项目建设的背景和必要性

## （1）满足高速增长的市场需求，全面提升市场竞争力

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，是加快工业转型升

级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。覆铜板行业作为电子信息产业的重要组成部分，是我国政府高度重视和大力支持发展的产业。我国先后出台多项政策，将覆铜板行业相关产品列为重点发展对象，为覆铜板行业的发展提供了政策支持。在国家加快发展电子元器件和 5G 产业的背景下，我国覆铜板产业迅速发展，覆铜板的技术水平也从中低端逐渐向高端发展，在技术发展中，高频高速成为覆铜板的主流方向，市场需求呈现高速增长态势。

公司的下游行业客户一般为 PCB、通信终端行业较为知名的大型企业，其经营规模要远大于本公司，且近年来还在持续扩产。随着合作的逐步深入和主要客户认证的取得，可以预见未来短期内公司产能较难满足下游客户持续增长的市场需求，需要通过新建项目的实施进一步扩充产能。

项目达产后公司新增高频高速覆铜板年产能 450 万平方米、粘结片年产能 250 万平方米，产能扩充将加速公司在高端覆铜板市场的业务布局，加快公司向行业优质客户的纵向拓展，提升高频高速电子电路基材等高附加值产品的技术水平、生产能力及业务规模，从而提升公司市场地位，全面提升公司市场竞争力。

### **(2) 缩短产品交付周期，降低制造成本**

随着公司业务量的不断增长，现有生产场地对生产的制约愈加明显，限制了产品生产规模的进一步扩大。募投项目实施后，将增大生产场地，并按照产品类别划分生产线，实现生产的规模化，进而缩短生产周期，降低制造成本，以适应下游企业对产品需求的快速增长。

### **(3) 优化公司业务结构，提升盈利能力**

公司是一家专业从事信息产业相关应用产品开发的高新技术企业，具有较为完整的通信产业链布局，在传统广电领域相关业务由于广电行业所面临的环境日趋复杂，竞争日益激烈，毛利较低。公司在多年的经营活动中积累了大量的覆铜板业务相关的技术研发、生产工艺优势，随着移动互联网、云计算、物联网、5G、航天航空、军事领域等电子技术的日益发展，高频高速覆铜板材料的需求增长迅速，行业正值高端化突破黄金时期，进口替代空间大。扩大产能，加速突破多种材料路线，不仅可以满足高速增长的市场需求，实现业务收入的高速增长，同时提升高频高速电子电路基材等高附加值产品业务收入占比，优化公司业务结构，进而提升公司盈利能力。

### 3、项目建设的可行性

#### (1) 项目建设符合国家政策支持方向

本项目高频高速覆铜板产品属于国家鼓励和扶持的新材料产品。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），覆铜板产品属于“新材料产业”中的“高性能热固性树脂基复合材料”，高频高速覆铜板下游 PCB 及其终端应用产品则涵盖了“新一代信息技术产业”及“新能源汽车产业”等领域。《信息产业发展指南》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列国家政策及指导性文件的推出，对高频高速覆铜板行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境，同时为本项目的经营发展提供了强有力的政策支持，带来积极影响。各项产业政策的陆续出台，彰显了国家促进高端新材料领域发展创新、鼓励扩大高频高速覆铜板产能、最终实现新材料及电子产业国产化的信念和决心，为高频高速覆铜板行业的健康发展提供了良好的政策环境。因此，多项国家政策的颁布为本项目建设提供了政策和市场保障。

#### (2) 公司掌握相关核心技术，项目实施具有技术研发基础

公司是一家专业从事信息产业相关应用产品开发的高新技术企业，具有较为完整的通信产业链布局，掌握核心技术研发、工艺到产品大规模生产制造的产品链，具备为客户提供整体配套及一站式服务的能力，研发实力较强，研发体系较为完善。截止 2021 年 6 月 30 日，已获得 33 项软件著作权，76 项授权专利。公司通过自主研发，大力开展新产品研发和老产品持续改进，持续丰富产品系列，优化产品性能，提高产品竞争力。在研发理念上，公司积极引入生命周期理念、风险控制理念，优化研发设计和研发管理，为获得持续性的研发成果做好管理支撑。

公司在本次项目建设产品的高频高速覆铜板领域有着深厚的技术研发基础和积累。公司高频高速覆铜板相关产品在 2015 年进行了国家科学技术部的科学技术鉴定，专家组认为：“公司研制的高频覆铜板产品技术达到国际先进水平，一致通过该产品的技术鉴定。建议进一步加大市场开拓力度，提高产业化水平”。公司自主研发的电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔实施方案获得国家“工业转型升级强基工程”中标，项目由政府给予 3,600 万元资金支持，并于 2019 年 6 月通过工信部的验收。

#### (3) 公司产品有一定的客户基础，覆铜板行业正值进口替代黄金时期

公司产品目前已有一定的客户基础，已与大富科技、盛路通信、通宇通讯等公司建立了长期合作关系，产品销售渠道已初步搭建完成，且随着技术逐步磨合改善，产品销量逐步攀升。同时，公司已与国内终端通讯龙头企业华为、中兴通讯商谈合作相关事宜，目前正在积极推进相关产品的认证工作。未来随着终端核心客户技术认证的陆续获得，公司高频高速覆铜板产品销量将会有显著提升。

随着中国大陆覆铜板企业的不断发展，包括高斯贝尔在内的覆铜板企业，长期专注于高频高速覆铜板的研发和生产，加速突破多种材料路线，覆铜板行业正值高端化突破黄金时期，进口替代空间大。公司主推的高频高速覆铜板系列产品，产品性能和技术指标已达国外进口同类产品水平，并且在关键核心技术上拥有自主知识产权及相关授权专利，具有广阔的市场空间。

#### 4、项目投资概算

本项目总投资额 28,000.00 万元，项目投资明细如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占比
1	装修及改造费用	1,470.00	5.25%
2	设备购置及安装费用	21,862.00	78.08%
3	项目建设其他费用	1,050.00	3.75%
4	预备费	1,218.00	4.35%
5	铺底流动资金	2,400.00	8.57%
	合计	<b>28,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、项目预期收益

经测算，本项目正常达产年度，预计年均营业收入为 100,000.00 万元，净利润为 5,140.13 万元，项目预期效益良好。

#### 6、项目建设期

本项目建设期为 2 年。

#### 7、项目实施主体

本项目实施主体为发行人全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司。

#### 8、项目的用地情况及审批程序

本项目建设地点位于山东省潍坊市寒亭街道办事处科技孵化产业园三期，拟通过租

赁潍坊嘉实孵化产业园有限公司现有厂房实施，不涉及新增用地和新增建筑物，潍坊嘉实孵化产业园有限公司已取得现有土地的不动产权证书：鲁（2017）潍坊市寒亭区不动产权第 0076255 号，拟租赁厂房的产权证明尚在办理过程中。项目立项、环评等备案、审批手续均在办理过程中。

## （二）补充流动资金

### 1、项目概况

公司拟将本次非公开发行募集资金 8,706.14 万元用于补充流动资金。本次使用部分募集资金补充流动资金，可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，降低财务风险和经营风险，增强竞争力。

### 2、项目实施的背景和必要性

公司在传统广电领域相关业务由于广电行业所面临的环境日趋复杂，竞争日益激烈，毛利较低。同时公司既有业务构成中，海外收入占比较高，占比达到 50-60%，受中印关系和疫情的双重影响，订单急剧下降且竞争日益激烈。高频高速覆铜板是业务结构优化调整的重要方向，公司在多年的经营活动中积累了大量的覆铜板业务相关的技术研发、生产工艺优势，产品目前已有一定的客户基础，产品销售渠道已初步搭建完成，且随着技术逐步磨合改善，产品销量逐步攀升。

随着公司主营业务的发展，以及未来募投项目的实施，公司各板块对流动资金的需求将持续增加。公司通过非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金后，能有效缓解公司发展的资金压力，净资产规模将增加，资本结构得以优化，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，具有必要性和合理性。

### 3、补充流动资金的可行性

#### （1）本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次非公开发行募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，有利于进一步改善公司流动性水平，能够有效缓解公司经营活动扩展带来的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

#### （2）公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系



公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并在日常生产经营活动过程中通过不断改进和完善，形成了符合上市公司治理要求的、规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已根据相关规定建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会、监事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，切实防范募集资金使用风险。

### 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

#### （一）本次发行对公司经营管理的影响

公司本次非公开发行募集资金将用于年产 450 万平方米高频高速覆铜板山东基地建设项目和补充流动资金，本次募投项目的实施，是公司把握国家在新能源产业和新兴消费电子领域政策支持、顺应新能源行业 and 新兴消费电子领域蓬勃发展市场机遇的重要举措，符合公司战略规划。募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力。同时，随着募投项目的实施推进，高频高速电子电路基材等高附加值产品业务收入占比将得到较大幅度的提升，优化了公司的业务结构，进而提升公司盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。

#### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行将为公司产能建设和持续发展提供强有力的资金支持。一方面，本次发行完成后，公司净资产规模将得以提高，有效增强公司的资本实力；同时，公司资产负债率得以降低，有利于优化资本结构，降低财务风险。另一方面，由于新建项目产生效益需要一定的过程和时间，因此每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到显著提升。

### 四、募集资金投资项目可行性分析结论

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合公司实际资金需求和公司整体战略发展方向，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次非公开发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有所提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险、提高后续融资能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司



及全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要且可行的。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日